

证券代码：300474

证券简称：景嘉微

公告编号：2018-077

## 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 18 日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于<公司本次非公开发行 A 股股票方案>的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案，并于 2018 年 2 月 5 日召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司本次非公开发行 A 股股票方案>的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。

2018 年 5 月 28 日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于<公司创业板公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案，并公告了《长沙景嘉微电子股份有限公司创业板公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

为便于投资者理解和查阅，公司就《长沙景嘉微电子股份有限公司创业板公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》涉及的主要内容修改说明如下：

| 预案章节  | 内容       | 修订情况                                                                                                |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 特别提示  | -        | 1、更新了本次非公开发行股票预案的审议程序；<br>2、修订了本次非公开发行股票预案的募集资金金额、募集资金用途和各认购对象的认购金额；<br>3、修订了公司总股本和本次非公开发行数量上限相关内容。 |
| 释义    | -        | 1、修订了本次发行、本次非公开发行、本次非公开发行股票的含义；<br>2、修订了本预案、最近三年、报告期、报告期末等相关术语的含义；<br>3、增加了补充协议的释义。                 |
| 第一节 本 | 一、公司基本情况 | 修订了发行人注册资本。                                                                                         |

|                                                            |                                             |                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 次 非 公 开<br>发 行 股 票<br>方 案 概 要                              | 四、本次非公开发行方案概要                               | 1、修订了本次非公开股票的发行数量上限；<br>2、修订了本次非公开股票的募集资金金额及用途。                                                                                                                                                               |
|                                                            | 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化                         | 1、修订了本次非公开发行股票数量上限；<br>2、修订了本次发行前后公司控股股东、实际控制人控制的股权比例情况。                                                                                                                                                      |
|                                                            | 七、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序                     | 更新了本次非公开发行股票预案的审议程序。                                                                                                                                                                                          |
| 第二节 发<br>行 对 象 基<br>本 情 况                                  | 一、国家集成电路产业投资基金股份有限公司                        | 1、更新了国家集成电路产业投资基金股份有限公司主营业务情况；<br>2、更新了最近一年的简要财务数据。                                                                                                                                                           |
|                                                            | 二、湖南高新纵横资产经营有限公司                            | 1、更新了湖南高新纵横资产经营有限公司注册资本和主营业务情况；<br>2、更新了最近一年的简要财务数据。                                                                                                                                                          |
| 第三节 附<br>条 件 生 效<br>的 股 票 认<br>购 协 议 及<br>补 充 协 议<br>摘 要   | 一、合同主体和签订时间                                 | 补充披露了补充协议的签署时间。                                                                                                                                                                                               |
|                                                            | 二、本次股份认购方案                                  | 1、修订了本次非公开发行的发行数量上限、募集资金总额；<br>2、修订了本次股份认购的认购方式、认购金额和认购数量；<br>3、修订了本次非公开发行的募集资金用途；<br>4、补充了进一步约定条款。                                                                                                           |
|                                                            | 六、协议的生效和终止                                  | 补充了与补充协议相关的生效和终止条款。                                                                                                                                                                                           |
| 第四节 董<br>事 会 关 于<br>本 次 募 集<br>资 金 使 用<br>的 可 行 性<br>分 析   | 一、本次募集资金的使用计划                               | 修订了本次非公开发行股票募集资金金额和用途。                                                                                                                                                                                        |
|                                                            | 二、本次募集资金投资项目基本情况                            | 1、更新了中国集成电路产业销售额等行业数据；<br>2、调整了高性能通用图形处理器研发及产业化项目和面向消费电子领域的通用类芯片研发及产业化项目的项目建设用地的表述；<br>3、调整了面向消费电子领域的通用类芯片研发及产业化项目的募集资金投入金额和比例，以及经济效益估算值；<br>4、删去了“芯片设计办公大楼”项目相关情况；<br>5、调整了补充流动资金的募集资金投入金额；<br>6、更新了发行人财务数据。 |
| 第五节 董<br>事 会 关 于<br>本 次 发 行<br>对 公 司 影<br>响 的 讨 论<br>与 分 析 | 一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况 | 1、修订了本次非公开发行股票数量上限；<br>2、修订了本次发行前后公司控股股东、实际控制人控制的股权比例情况。                                                                                                                                                      |
|                                                            | 五、本次发行对公司负债的影响                              | 更新了发行人财务数据。                                                                                                                                                                                                   |

|                         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | 六、本次股票发行相关风险说明                                    | 1、更新了发行人的财务数据；<br>2、更新了本次非公开发行股票预案的审议程序。                                                                                                                                                                                         |
| 第六节 利润分配政策及其执行情况        | 二、公司制定的《未来三年股东回报规划（2018年—2020年）》                  | 更新了《未来三年股东回报规划（2018年—2020年）》的审议程序。                                                                                                                                                                                               |
|                         | 三、最近三年利润分配及未分配利润使用情况                              | 补充披露了发行人 2017 年年度利润分配情况。                                                                                                                                                                                                         |
| 第七节 董事会关于本次发行相关的声明及承诺事项 | 二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司董事会作出的有关承诺并兑现填补回报的具体措施 | 1、调整了本次非公开发行股票募集资金总额和用途；<br>2、调整了相关董事会决议届次；<br>3、修订了公司发行前总股本、本次发行的股份数量上限和发行后的总股本；<br>4、根据公司最新财务数据、经营情况和股本情况调整了本次非公开对扣除非经常性损益后的每股收益影响的假设前提和测算；<br>5、更新了公司从事募投项目在人员、技术等方面的储备情况；<br>6、更新了公司现有业务主要风险及改进措施；<br>7、更新了本次非公开发行股票预案的审议程序。 |

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司董事会

2018 年 5 月 28 日